

第 115 回マイクロ接合研究委員会 プログラム

日 時：平成 28年 9月 13日(火) 10:30～16:30

場 所：大阪大学 医学・工学研究科 東京ブランチ 913 会議室(東京 日本橋)

	時 間	題 目	講 演 者
平成 28 年 9 月 13 日 (火)	司 会 佐野智一 (大阪大学)		
	10:30～11:15	『金属積層造形と実使用に向けた後工程』 (資料番号MJ-702-2016)	金属技研(株) ○尾ノ井正裕
	11:15～12:00	『高耐圧パワー半導体向け絶縁基板の 電気試験技術と機械電気両立設計』 (資料番号MJ-703-2016)	富士電機(株) ○早瀬悠二
	12:00～13:10	昼 食 休 憩	
	13:10～13:20	委 員 会 議 事	
	司 会 武井利泰 (日本精工(株))		
	13:20～14:05	『排熱回収用熱電変換モジュール』 (資料番号MJ-704-2016)	日立化成(株) ○東平知丈、地主孝広 根岸征央、山本札
	14:05～14:50	『高温動作パワーモジュールにおける 銀焼結接合の信頼性』 (資料番号MJ-705-2016)	三菱電機(株) ○巽 裕章
	14:50～15:00	休 憩	
	司 会 岩本知広 (茨城大学)		
	15:00～15:45	『High power electronics packaging by TLP bonding』 (資料番号MJ-706-2016)	Empa, Switzerland (現 大阪大学) ○Adrian Lis
	15:45～16:30	『酸化物接合界面の原子構造と偏析元素』 (資料番号MJ-707-2016)	東京大学 ○幾原雄一

※プログラムは都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。